

深圳市景旺电子股份有限公司

关于公开发行A股可转换公司债券募集资金运用 的可行性研究报告

一、募集资金运用计划

公司本次公开发行A股可转换公司债券拟募集资金总额不超过97,800.00万元，扣除发行费用后，拟用于以下项目的投资：

金额单位：万元

序号	项目名称	项目投资额	拟以募集资金投入
1	江西景旺精密电路有限公司高密度、多层、柔性及金属基电路板产业化项目（二期）	100,000.00	97,800.00
	合计	100,000.00	97,800.00

江西景旺高密度、多层、柔性及金属基电路板产业化项目（二期）建成达产后，将形成年产240万平方米印制电路板产能。

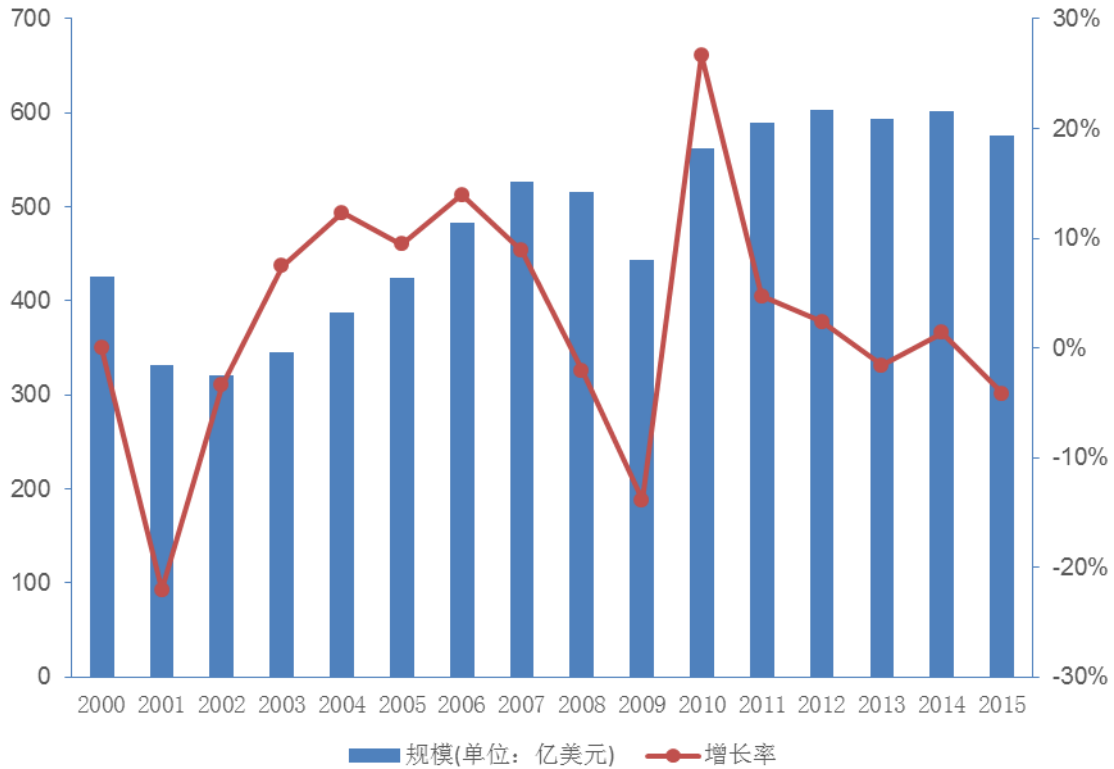
上述项目的实施主体为公司全资子公司江西景旺。本次募集资金到位后，将通过向江西景旺增资的方式投入，江西景旺根据公司制定的募集资金投资计划具体实施。在募集资金到位前，公司可根据项目实际建设进度以自筹资金先行投入项目，待募集资金到位后予以置换。若本次实际募集资金不能满足上述项目的资金需求，不足部分由公司自筹解决。

二、募集资金投资项目的实施背景

（一）PCB 全球市场前景广阔，全球 PCB 产业中国大陆转移

根据世界电子电路联盟（WECC）的统计，2015 年全球 PCB 产业销售额约为 576.28 亿美元。根据市场分析机构 Prismark 的预测，2016 年-2021 年全球 PCB 产值的年均复合增长率约为 2.2%。全球 PCB 行业市场容量巨大，未来几年行业总体将呈稳步增长态势。

2000-2015 年全球 PCB 市场发展状况

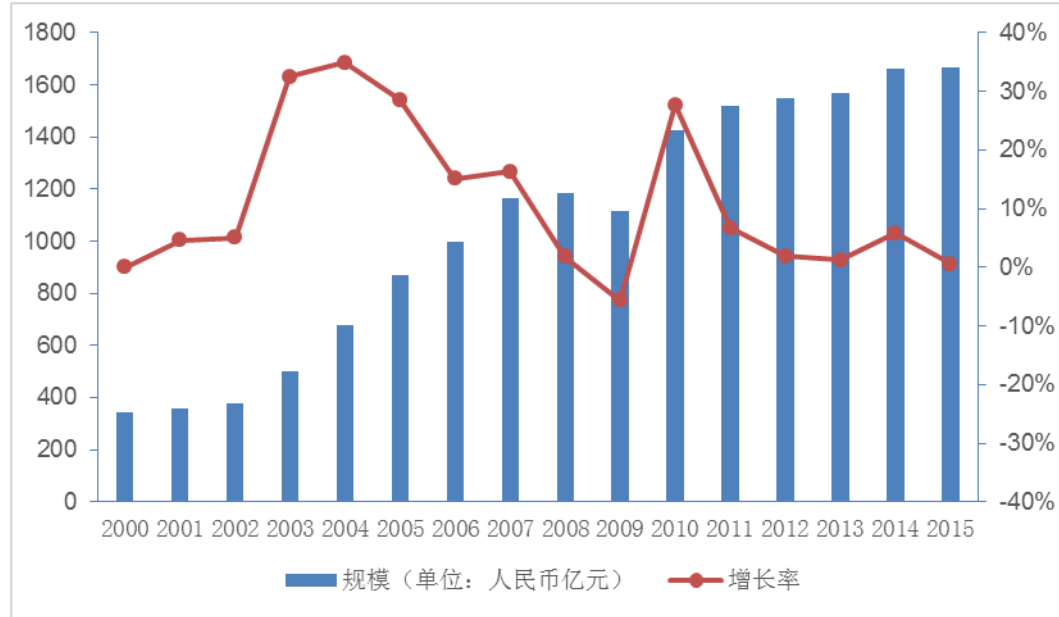


据来源: WECC、CPCA

近十年来,随着亚洲尤其是中国在劳动力、资源、政策、产业聚集等方面的优势,吸引着全球电子制造业产能向中国、中国台湾和韩国等亚洲地区进行转移。2006年中国超越日本成为全球PCB行业最大的生产基地。

受益于全球PCB产能向中国转移以及下游蓬勃发展的电子终端产品制造的影响,中国PCB行业整体呈现较快的发展趋势,据WECC、CPCA(中国印制电路行业协会)统计,2015年中国PCB的总体规模为1,669亿元,占全球市场规模的比例约46.6%。2000年至2015年期间,中国PCB市场规模年均复合增长率达11.10%,远高于全球平均水平2.03%。

2000-2015年中国PCB市场规模情况



数据来源：WECC、CPCA

根据 Prismaark 的预测，2016 年-2021 年中国 PCB 产值的年均复合增长率约为 3.4%，继续高于全球和其他地区的增速。其中，汽车电子的普及和通讯行业投资升级有望推动 PCB 行业的需求。

（二）政策背景

电子信息产业是我国重点发展的战略性支柱产业，印制电路板行业作为电子产品的基础产品，受到国家政策的大力支持。根据我国工业与信息化部《信息产业科技发展“十一五”规划和2020年中长期规划纲要》，印制电路板（特别是多层、柔性、柔刚结合和绿色环保印刷线路板技术）是我国电子信息产业未来重点发展的项目。在《外商投资产业指导目录》和《产业结构调整指导目录》中，印制电路板（主要是高密度互连积层板、多层柔性板、刚挠印制电路板及封装基板）同样被列为鼓励类产业。国家通过出台这些政策，促进和引导印制电路板行业的良性发展，为未来PCB行业的进一步壮大提供了制度保障。

（三）公司经营背景

公司通过多年的发展及在印制电路板行业的深耕细作，积累了丰富的业务经验，发展了一批粘度高、业务关系稳定的优质客户；公司目前产品覆盖刚性电路板、柔性电路板、金属基电路板三大类，能满足客户多元化的产品需求，三条产品线的合理布局，使公司能为客户提供多样化的产品，在市场竞争之中处于优势地位，为公司主营业务收入的持续增长。

近年来，为满足客户日益增长的需求，公司印制电路板产量不断上升，尤其是刚性板的产能利用率较高，产能不足问题凸显，公司的刚性板产能亟待增加。

三、募集资金投资项目实施的必要性

（一）解决产能瓶颈，适应行业发展和满足市场需求

2014 年至 2016 年，公司主营业务收入持续快速增长，年均复合增长率为 21.15%。公司产能利用率已处于较高水平，2016 年度公司综合产能利用率为 95.06%，其中刚性电路板业务的产能利用率为 96.83%。受到场地及资金的限制，公司难以迅速扩大产能。

随着公司市场竞争力的不断提升，并受到中国 PCB 产业稳步增长、产业整合加快、下游新兴产业需求增长等有利因素的影响，预计未来几年公司产品的市场需求将持续增长，产能不足的问题将日益凸显。

通过实施本次募投项目，公司将新增年产 240 万平米刚性板产能，较 2016 年刚性板产量 277 万平方米，公司生产能力实现大幅提高，对于公司在稳定现有优质客户群的同时继续扩大市场占有率具有重要的意义。

（二）巩固市场地位，提升核心竞争力

根据中国印制电路行业协会的统计，2014 年公司在中国印制电路行业排行榜中名列第 19 位，内资企业（内资持股超过 51%）排名中位列第 3 位，市场占有率 1.3%；2015 年公司在中国印制电路行业排行榜中名列第 14 位，内资企业排名中位列第 2 位，市场占有率 1.97%；2016 年公司在中国印制电路行业排行榜中名列第 10 位，内资企业排名中位列第 2 位，营业收入相比 2015 年增长了 22.63%。根据全球知名的调研机构 N.T.information 发布的全球 PCB 制造商排行统计数据，2014 年~2016 年公司排名全球第 40 名、34 名和 32 名，排名稳步上升。

面对 PCB 行业良好的发展空间及未来我国快速增长的市场需求，国内的 PCB 厂商积极参与竞争，在质量、交期、规模等方面充分竞争。为了应对竞争压力，保持公司在国内外 PCB 行业的主要厂商地位，公司需要在经营规模、生产能力、产品结构与技术实力等方面进行全方位的提升。

本次募集资金投资项目实施后，公司在经营规模、产品档次、技术实力等方

面将进一步发展，公司的核心竞争力与市场地位将得以巩固。

（三）实施自动化战略转型

本次募投项目通过对加强自动化生产设备投入，进一步扩大刚性电路板的产出，发挥规模效应，降低单位产品的成本。目前，国内人口红利正在消失，劳动成本增加，一定程度上阻碍了国内大量工业企业的可持续经营和发展。公司引入自动化生产线，降低管理费用和人力成本，跟随全球趋势走向信息化、自动化，结合公司二十多年的技术和人才积累，本次募投项目的设备精密化程度、自动化水平、生产流程的优化程度将有较大幅度的提升，随着募投项目的实施，公司经营规模将进一步扩大。

四、募集资金投资项目实施的可行性

（一）项目符合公司现有战略目标与经营规模

公司专注于印制电路板行业，以“成为全球最可信赖的电子电路制造商”为愿景，以刚性电路板、柔性电路板、金属基电路板三个产品线为核心，横向发展高密度互连板，纵向拓展配套贴装业务及树脂配方开发技术。公司的中长期战略是：以技术创新为平台，通过精益管理，不断强化企业核心竞争力，最终成为具有可持续发展能力和国际影响力的现代企业。

本次募集资金将投入到扩大刚性电路板产能中，公司董事会经分析后认为：募集资金投资数额和投资项目与公司现有的生产经营规模、财务状况和管理能力等相适应，投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，公司能够有效使用募集资金，提高生产经营效益，本次投资项目与公司战略目标一致。

（二）行业发展前景良好

1、PCB 行业市场容量巨大

根据世界电子电路联盟（WECC）的统计，2015 年全球 PCB 产业销售额约为 576.28 亿美元。根据市场分析机构 Prismark 的预测，在全球电子信息产业持续发展的带动下，2016 年-2021 年全球 PCB 产值的年均复合增长率约为 2.2%。全球 PCB 行业市场容量巨大，未来几年行业总体将呈稳步增长态势。

2、中国 PCB 行业发展迅速

2000 年以前,美洲、欧洲和日本三大地区占据全球 PCB 生产 70%以上的产值,是最主要的生产基地。但近十年来,随着亚洲尤其是中国在劳动力、资源、政策、产业聚集等方面的优势,吸引着全球电子制造业产能向中国、中国台湾和韩国等亚洲地区进行转移。

2002 年,中国的 PCB 市场规模还不到 45 亿美元,全球市场占有率不高。2006 年,中国 PCB 产值正式超过日本,成为全球第一。根据 WECC、CPCA 统计,2015 年中国 PCB 产值约为 1,669 亿元(约合 268.5 亿美元),约占全球市场规模的 46.6%。2000 年至 2015 年期间,中国 PCB 市场规模年均复合增长率达 11.10%,远高于全球平均水平 2.03%。根据 Prismark 的预测,2016 年-2021 年中国 PCB 产值的年均复合增长率约为 3.4%,继续高于全球和其他地区的增速。

(三) 公司研发实力与客户资源为项目实施提供保障

公司为国家高新技术企业,于 2006 年建立技术研发中心,于 2015 年成立中央实验室,逐步健全了公司的研发体系;公司已取得多项专利成果,并在生产经营过程中积累了丰富的非专利技术;公司建立应用技术创新激励机制,鼓励员工在基础应用技术的不断创新,优化生产流程和提高生产效率,公司具备较强的研发技术水平和管理能力。

公司凭借良好的产品品质和服务水平,已积累一批优质客户。公司下游客户分布广泛,抗单一行业波动风险的能力较强。公司客户包括天马、信利集团、维沃(vivo)、海拉、华为、中兴、冠捷、霍尼韦尔、亚旭、罗技、ICAPE、POWER-ONE 等国内外知名企业,这些客户普遍对供应商的资质要求高,体系认证周期长。同时,公司注重与客户建立长期战略合作关系,与重点客户已合作多年,业务关系稳定,多次获得客户颁发的“优秀供应商”等称号。

五、募集资金投资项目的的基本情况

(一) 项目建设地点及实施主体

建设地点:江西省吉水县城西工业园内

实施主体:江西景旺精密电路有限公司

（二）项目建设内容

本项目拟在吉安市吉水县城西工业园内进行江西景旺精密电路有限公司高密度、多层、柔性及金属基电路板产业化项目（二期）的生产建设，通过引进先进生产设备，完善配套的公用、辅助设施以及环保处理设施，增加年产 240 万平方米印制电路板产能。

（三）项目建设期

本项目的建设期为 3 年。

（四）项目投资估算

本项目总投资为 100,000.00 万元，其中拟使用募集资金投入 97,800.00 万元。

（五）项目经济效益评价

本项目建成达产后，预计实现不含税年销售收入 158,496.00 万元，年利润总额 34,328.98 万元，项目投资回收期 6.27 年（税后）。

（六）项目涉及的政府批报情况

本项目已取得吉水县发展和改革委员会的备案，备案文号为吉发(基)[2016]171 号。项目涉及的其他政府部门审批事项正在办理中。

六、本次公开发行可转债对公司经营情况和财务状况的影响

（一）对公司经营情况的影响

1、对公司生产经营规模的影响

募投项目建成并达产后，预计实现不含税年销售收入 158,496.00 万元，带动公司收入的大幅增长。2016 年，公司主营业务收入为 323,105.42 万元，本项目达产后年销售收入相比 2016 年增长 49.05%。

2、对经营业绩的影响

本次募集资金投资项目投产后将扩大公司的经营规模，增强公司持续盈利的能力，促进经营业绩的提升。募投项目建成并达产后，预计新增年销售收入 158,496.00 万元，年利润总额 34,328.98 万元。

3、对净资产收益率和盈利能力的影响

本次募集资金到位后，公司净资产将大幅增长，但项目达产实现收益需要一定的时间。因此，募集资金到位后，预计短期内公司净资产收益率较以前年度会有所下降。随着项目达产，公司营业收入和净利润增加，净资产收益率也将相应回升。

（二）对公司财务状况的影响

本次募集资金投资项目的建成，将大幅提高公司的资产规模。本项目计划总投资 100,000.00 万元，其中，固定资产投资 94,746.73 万元（含税）。截止 2017 年 6 月 30 日，公司总资产 440,817.02 万元、固定资产账面价值 113,668.31 万元，随着募投项目的投资逐步完成，公司总资产规模及固定资产规模的提高将进一步增强公司抵御风险的能力，公司的运营规模及经营效益也将进一步提升。

七、综述

综上所述，公司本次募集资金数额和投资项目与公司现有生产经营规模、财务状况、技术水平和管理能力等相适应，符合本公司及全体股东的利益，具有必要性和可行性，投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，公司能够有效防、范投资风险，提高募集资金使用效益。同时，公司战略发展方向符合相关法律法规和国家政策，有利于巩固公司市场地位，提高公司核心竞争力，为公司可持续发展奠定基础。

深圳市景旺电子股份有限公司董事会
2017 年 9 月 5 日